



アルカリ現像型PKG用DFSR AUS SR3 (薄型、コアレスサブストレート対応)

Photo-imageable Solder Resist for Ultra Thin/Coreless application

特徴 Features

- 高弾性率/高剛性 (High Modulus & Stiffness)
- 優れた解像性 (High Resolution)
- 低CTE/高Tg (Low CTE/High Tg)
- ドライフィルムタイプ (Dry film type)
- 高強度 (High Strength)

特性 Properties

ガラス転移点 Tg *TMA method	150-160°C
線膨張係数 CTE (α_1)	15-20ppm
弾性率 Young's modulus *DMA method	12.5-13.5Gpa
破壊強度 Tensile strength	90-100MPa
破壊伸び率 Elongation	2.0-3.0%
HAST耐性 (130°C/85%RH, 5V, L/S=12/13)	300h Pass

